

双组份导热灌封胶

GF400是一款低粘度高效导热有机硅双组份灌封胶，导热系数4.0W/(m·K)，分为A、B组分，按照1:1混合，混合均匀后能自排泡和常温固化，固化后具有防尘、防水防震、阻燃、密封、粘接、导热功能和优异的填缝效果，可用于发热电子元件的导热封装。



特性和优点

- 导热系数4.0W/(m·K)
- 操作时间可调
- 高电气绝缘
- 流动性、浸润性好
- 可实现自动化作业

典型应用

- OBC, DC-DC, 连接器, 传感器, 放大器等
- LED, 电源, 功率转换器, 变压器, 高压电阻器

***操作时间：**混合后，在操作时间内使用完毕

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色(A/B)	白色/黄色	目视
粘度(Pa·s)	part A: 15±3	ASTM D2196 @7号转子/转速60rpm
	part B: 15±3	
操作时间(h) @25℃	>1	操作时间：A/B混合后在一起粘度上升到初始值两倍的时间
固化时间(h) @25℃	<4	
固化时间(h) @60℃	<0.5	
固化后		
密度(g/cc)	3.1±0.1	ASTM D792
硬度(Shore 00)	60±10	ASTM D2240
拉伸强度(MPa)	>0.15	ASTM D412
断裂伸长率(%)	>50	ASTM D412
撕裂强度(N/mm)	>0.3	ASTM D624
重量损失(%, 析出)	<1.0	滤纸吸附 @压缩25%/125℃/48h
耐温范围(℃)	-60~200	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	3	温度<40℃密封储存、避免暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	>7.0	ASTM D149
介电常数(@1000Hz)	6.7	ASTM D150
体积电阻率(Ω·cm)	>10 ¹³	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	4.0±0.4	ISO 22007-2
热膨胀系数(ppm) @-40~150℃	50±10	ASTM E831-2014